

奇景光電 推出業界第一個內建AI機器學習功能的超低功耗WiseEye WE-I Plus晶片

【台南，2019 年 10 月 7 日】奇景光電（納斯達克代號：HIMX）今（7）日宣布，推出業界第一個先進的人工智慧邊緣運算〔Edge AI〕晶片 WiseEye WE-I Plus，此晶片內建 AI 加速器，具有機器學習功能、智慧影像檢測和語音識別，可供開發者在此晶片平台上，發展類神經網路機器學習，應用在包含智慧家電及監控系統的智慧物聯網產品。

奇景 WiseEye WE-I Plus 晶片，採用可程式的處理器，支援數位訊號處理加強功能，並內建硬體加速模組如 CDM、HOG 及 JPEG 等，支援實時的移動偵測、物體偵測、及影像處理。為滿足開發者在智慧物聯網產品，對安全防護的需求，奇景 WiseEye WE-I Plus 晶片平台，提供軟、硬體整合的安全防護方案，包含安全啟動、透過安全的即時網路下載技術升級、透過 TLS 網路安全協定傳送資料等。為達到超低功耗及更長的電池使用壽命，奇景 WiseEye WE-I Plus 晶片，內建線性穩壓器和電源管理單元，支援暫停運行、全時感測及高效電腦視覺等運算模式。此外，奇景 WiseEye WE-I Plus 晶片平台，亦提供軟體程式庫、文件系統及工具鏈，使機器學習技術能更有效率處理，從各種感測器收到的影像及聲音資料。

奇景光電亦提供方便使用的軟硬體開發套件，使開發者評估 WiseEye WE-I Plus 晶片平台最佳化，開發者可以快速導入、實做他們在智慧家電、監控系統、及智慧物聯網的方案，並加快產品發布時程。奇景軟硬體開發套件，包含 WiseEye WE-I Plus 晶片、VGA/QVGA 影像感測器、人體紅外線感測器、溫度感測器、環境光感測器、麥克風及發光二極管。另外，奇景軟硬體開發套件，亦提供 WiFi 無線網路擴充板及 UART、I2C、SPI 等介面，轉換成 USB 介面，連接到電腦的擴充板。在軟體方面，奇景軟硬體開發套件，提供全面性的機器學習，和數位訊號處理程式庫，亦具有方便使用的程式設計環境和線上仿真器。

奇景光電執行長吳炳昌表示，目前產業界使用電池並具有 AI 智慧感應功能的邊緣運算產品的需求正在快速成長，特別是在智慧家電、智慧門鎖、智慧電視、筆記型電腦，或智慧建築的控制和安全。奇景 WiseEye WE-I Plus 晶片平台，能支援需要低功耗、記憶體容量受到限制的聲音、影像處理的 AI 應用領域的機器學習框架，均可有效的移植到 WiseEye WE-I Plus 晶片平台上運作。奇景推出 WiseEye WE-I Plus 晶片平台後，從產業領導者和合作夥伴處，均得到正面回應。

奇景光電已於2019年 9月19 日，在美國聖塔克拉拉，舉行的新思ARC處理器會議，展示WiseEye Plus晶片平台方案，並將於2019年 10月16日於台灣台北和2019年 11月13日於中國北京，所舉行的新思ARC處理器會議，分別展示WiseEye Plus晶片平台方案。

關於奇景光電：

本公司係全球顯示器驅動 IC 與時序控制 IC 領先廠商，產品應用於電視、筆記型電腦、桌上型電腦、手機、平板電腦、數位相機、汽車導航、虛擬實境裝置以及其他多種消費性電子產品。奇景光電的其他產品並包含觸控面板控制 IC、手持式與擴增實境裝置使用的頭戴式矽控液晶光閥（LCOS）微型投影解決方案、汽車使用的抬頭顯示器、LED 驅動 IC、電源管理 IC、監視器及投影機控制晶片、客製化影像處理晶片解決方案及提供矽智權的授權等。奇景光電亦提供數位相機解決方案，包括用於擴增實境裝置、3D 感測及機器視覺的 CMOS 影像感測器及晶圓級光學鏡頭，這些產品已被廣泛地應用在手機、平板電腦、筆記型電腦、電視、網路攝影機、汽車、保全、醫療器材、家電及物聯網等。奇景光電設立於 2001 年，總部位於台灣台南，目前員工人數約為 2,100 人，分布於台南、新竹、台北、中國、韓國、日本、以色列與美國。至 2019 年 6 月 30 日為止，奇景光電在全球已取得 2,931 項專利，尚有 561 項專利正在申請中，產品應用於全球各種消費性電子品牌產品，技術領先並維持影像顯示處理技術半導體解決方案領導廠商的地位。

聯絡人：

黃華珮 / Jessica Huang
公共關係 資深專案經理
奇景光電股份有限公司
Himax Technologies, Inc.
+886-3-516-3276 分機 38817
jessica_huang@himax.com.tw

林芳妃 / Ophelia Lin
投資人關係 專案副處長
奇景光電股份有限公司
Himax Technologies, Inc.
+886-2-2370-3999 分機 22202
ophelia_lin@himax.com.tw

風險說明：

本新聞稿的部分展望未來的陳述，特別是有關於財務、產業預測，可能會導致實際結果與本新聞稿的描述不同，可能造成差異的因素包括但不限於整體市場與經濟的狀況、半導體產業的狀況、市場對本公司驅動 IC 產品及非驅動 IC 產品之接受度、產品競爭力、市場競爭、終端市場需求、對少數主要客戶的依賴度、持續創新的技術、新面板技術發展、發展與維護智慧財產權的能力、價格壓力如平均售價下滑或客戶訂單模式改變、全年有效稅率預估的改變、面板其他關鍵零組件短缺、政策法規改變、匯率波動、子公司新投資案、對客戶應收帳款的回收與存貨的管理、維護及吸引人才，包括本公司為 2018 年度所申報的 20-F 文件中「風險因素」標題項下的該等風險。不論是否有其他新的訊息或事件，本公司皆無義務公開更新或修改此風險說明。